

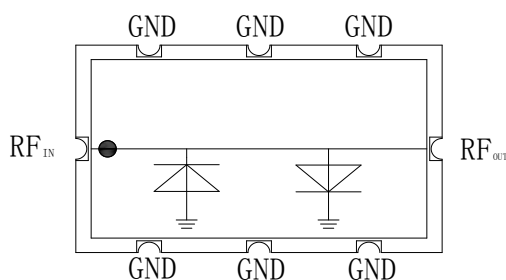
### 特点:

- 低插入损耗: 典型插入损耗 0.5dB
- 优异的输入输出匹配: 驻波比典型值 1.4:1
- 承受功率: 连续波 功率 1W
- SMT 封装
- 封装尺寸: 12.7\*7.62\*4.19mm

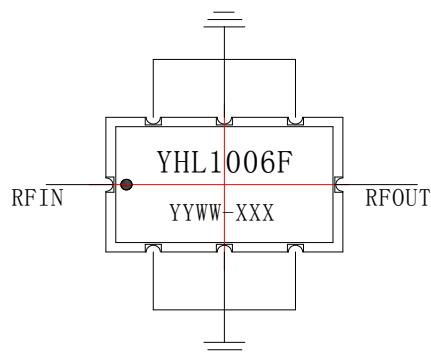
### 性能参数: (T<sub>A</sub>=-55~+85°C)

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	Z <sub>IN</sub> =Z <sub>OUT</sub> =50Ω	30		1000	MHz	
插入损耗	IL	f=30~1000MHz, RF <sub>IN</sub> 输入功率-20dBm		0.5	1.0	dB	
输入驻波比	VSWR <sub>I</sub>			1.4:1	1.8:1		
输出驻波比	VSWR <sub>O</sub>			1.4:1	1.8:1		
承受功率	P <sub>I</sub>	CW			1	W	常温+25°C测试
限幅电平	P <sub>O</sub>	RF <sub>IN</sub> 输入功率 1W	3		13	dBm	
质量	m				2.0	g	

### 功能框图:



### 推荐外围电路:

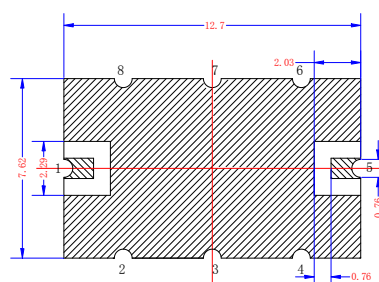


### 引脚定义:

引脚编号	符号	描述
1	RF <sub>IN</sub>	射频输入端, DC 耦合
5	RF <sub>OUT</sub>	射频输出端, DC 耦合
2/3/4/6/7/8	GND	接地端
底部焊盘	GND	接地端

### 推荐焊盘:

单位: mm

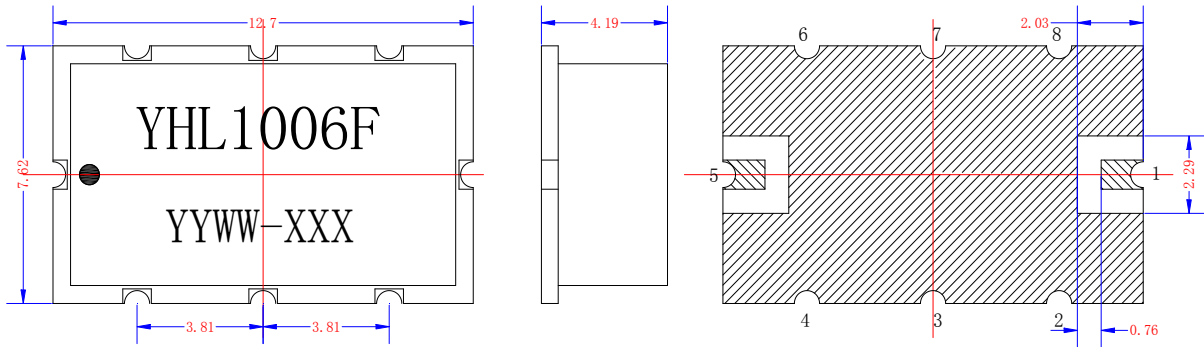


### 极限参数表:

参数名称	极限值
输入射频功率	+33 dBm
装配温度	183°C, 20s
工作温度	-55~+85°C
贮存温度	-55~+100°C
静电防护等级(HBM)	Class 1A

超过以上条件, 可能引起器件永久损坏。


**外形尺寸图:**



注：1、单位：mm，未注明公差按 $\pm 0.15\text{mm}$ ；

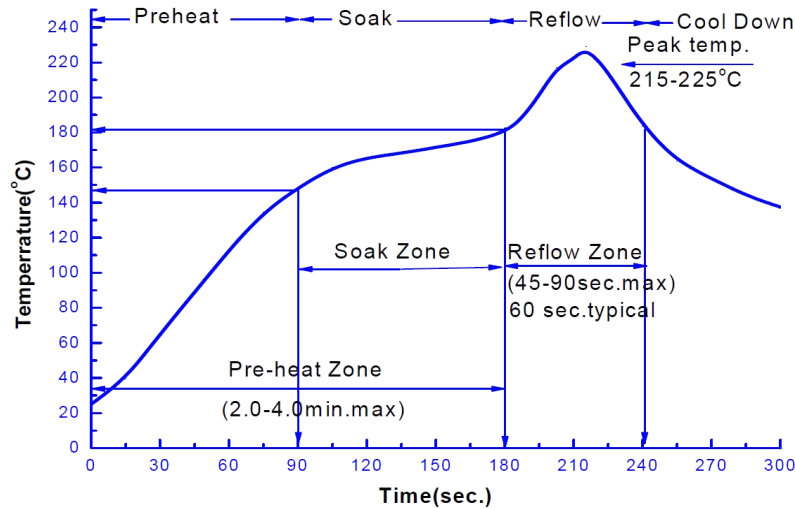
2、产品采用基片和金属屏蔽罩组合封装，标识采用激光刻字。

**字符标志及引脚定义:**

字符	定义	字符	定义
YHL1006F	产品型号	●	射频输入端
YYWW	批次号		接地
XXX	序列号		

### 产品使用注意事项:

- 1.产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
- 2.产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域）；
- 3.产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183℃回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 230℃。

- 4.如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。